

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

INTCERA
INTCERA HIGH TECH GROUP LIMITED
大陶精密科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

www.intcera.com

**暫停生產及本集團所涉
及若干訴訟之最新消息**

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板之要求而發表。

大陶精密科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)就本公司股份於二零零三年二月十三日起暫停買賣，並謹此澄清有關本公司及其附屬公司(「本集團」)暫停生產以待二零零三年四月將廠房遷往上海而發出本公佈。

台灣及中國廠房遷往上海

根據本公司於二零零二年十一月十三日發出之第三季度報告(「第三季度報告」)，本集團之台灣廠房已於二零零二年八月底停產，並遷往中國，而本集團亦計劃進一步提高中國廠房之生產能力，以增加市場佔有率，並藉遷廠而降低生產成本。

本集團一直致力開發中國光纖元件市場。本集團之中國廠房(「龍華廠房」)為加工工場，位於中國海關指定之自由貿易區——深圳龍華。由於本集團大部份客戶以台灣為基地，因此雖然內銷原先並非本集團主要考慮因素，惟本集團之製成品直接內銷受到規限，而該自由貿易區內可使用之廠房面積亦有所限制。倘本集團在中國不斷擴展，則顯而易見，本集團必須在中國建立地位，成為一家中國當地之公司。

在龍華廠房暫時停產之前，本集團將製成品由中國運送至主要以台灣為基地之多名客戶。

為進一步利用光纖元件在中國內銷之需求，董事現正於自由貿易區以外之地區物色合適廠址，並可能成立合資公司，將生產本地化，從而更有效進軍中國內地市場。此外，按本集團二零零二年第一季度報告所述，龍華廠房之主要業務乃為台灣廠房之產品進行打磨。將龍華廠房遷至上海，配合在台灣之生產線，可確保生產過程更加完善。

上海廠房

根據第三季度報告及二零零二年九月十八日發出之公佈所述，本集團現正籌備在上海以合資公司形式成立新廠房（「上海合資公司」），將台灣及龍華廠房之生產線遷往上海合資公司之新廠房。經整合後，本集團不但解決人手過剩問題，同時亦減低其他成本。為籌備遷廠，本集團約於二零零二年十一月暫停龍華廠房之營運。換言之，自二零零二年十一月起至上海新廠房開始投產之日（預期為二零零三年四月）期間，除與台灣之工業技術研究院（「技術研究院」）在台灣進行若干提高生產效率之研發項目外，本集團之生產業務暫時停止。

董事獲悉本集團已加快添置新機器、辦理清關手續及搬運機器等物流程序，以便配合上海廠房於二零零三年一月正式投產。然而，由於物流程序及清關手續所需之時間較預期長，故現時預期上海廠房須延至二零零三年四月方可投產。

暫時停產對本集團之影響

目前，本集團仍會向客戶進行銷售。本集團已就遷廠事宜向客戶發出通告，並於二零零二年十一月至二零零三年四月之過渡期間儲存充裕存貨。二零零二年下半年之銷售收益維持穩定，每月平均超過850,000港元。

此外，按二零零三年一月十三日發出之公佈及二零零三年二月十四日發出之通函所述，本集團預期於過渡期間因授出本集團之技術權而向深圳市威誼光通技術有限公司（「威誼」）收取技術權費用，因而取得收益。

當本集團股份首次公開上市時，陶瓷套圈之每月總產量約為600,000件。龍華廠房於停產及搬遷前之每月產量約為350,000件。按第三季度報告所述，本集團之生產活動當時全部在中國進行。上海廠房方面預期將於二零零三年四月開始每月生產750,000件，並於二零零三年七月增至1,500,000件。因此，暫時停產對本集團之陶瓷套圈產量有正面影響，由二零零二年十月之600,000件增至二零零三年四月之750,000件，再增至二零零三年七月之1,500,000件。

按本集團於二零零三年二月十四日發出之通函所述，本集團可優先購買威誼生產之陶瓷套圈。由於本集團之主席兼執行董事成清波先生同時為威誼之全資實益擁有人，因此根據創業板上市規則，威誼為本集團之關連人士。然而，威誼並非本集團成員公司。有關可優先購買威誼產品之安排將保證本集團之上海廠房於二零零三年四月投產前有另一陶瓷套圈之供應來源。威誼預期將於二零零三年三月初開始每月生產350,000件，並於二零零三年六月增至750,000件。遷廠往中國將使本集團之總產量（包括威誼之產量）由950,000件增至2,250,000件。產量增加而生產成本下降，為本集團帶來重大競爭優勢。

本集團暫時停產乃控制成本以獲取長遠利益之臨時措施。憑藉熟練之技術，加上不斷進行研發工作，本集團具備充足條件將技術權授予策略性夥伴。此外，本集團已為過渡期準備足夠存貨，直至上海恢復生產為止。於二零零二年十二月三十一日，本集團擁有合共約2,000,000件套圈存貨。另外，本集團現正與財務顧問商討，於二零零三年二月底前落實配售新股之條款。倘配售成功，將為本集團籌集約16,000,000港元。該等活動有助本集團於恢復生產之前維持業務。董事認為暫停生產及遷廠並不會對本集團之業務營運及財政狀況有任何重大不利影響。

本集團所涉及訴訟之最新消息

如本公司於二零零二年十月二十一日之通函所述，董事指出本公司在台灣的附屬公司大陶精密科技股份有限公司（「台灣大陶」）自二零零二年十月起牽涉入數宗台北地方法院的訴訟內。

在已披露的控告兩家租賃公司總額為32,894,050元新台幣（約7,831,900港元）之訴訟中，其中一宗之債務已獲償付約24,426,000元新台幣（約5,815,700港元）並告完結，另外一間租賃公司已同意在確定付款方案前暫停強制執行法律程序，而台灣大陶尚欠該公司8,468,050元新台幣（約2,016,200港元）。於二零零二年十月三十一日，台灣大陶之債務總額為155,569,067元新台幣（約37,040,200港元）。本公司正積極重組銀行債務，以尋求解決該等申索，包括繼續支付利息及延遲償付本金。目前，台灣大陶每月支付之利息約為580,000元新台幣（約138,000港元）。董事認為經適當處理仍可能產生對本公司有利之結果。此外，本集團仍繼續聘請一間台灣律師事務所就此繼續提供意見。根據本公司與威誼於二零零二年十二月二十九日訂立之技術權協議，所得款項之一半，合共2,500,000美元（19,500,000港元）將用作償還台灣及香港銀行貸款。倘於二零零三年二月底前配售成功，預計所得款項16,000,000港元其中約4,000,000港元將用作支付本集團重組債務後之利息。

按二零零二年十一月四日發出之公佈所披露，先前可換股債券部份所得款項27,400,000港元已用作支付銀行債務。此舉成功阻延台灣銀行向台灣大陶發出之若干傳票，並有助其與銀行商討債務重組。

有關傳票之和解

有關本公司就金英融資（香港）有限公司（「金英」）申索支付其財務顧問費合共845,970港元收到高等法院傳票而於二零零三年一月二十八日刊發之澄清公告，董事欣然公佈金英與本公司已商定同意作出命令形式和解，目前一份經雙方同意之傳票已在起草，以於二零零三年二月二十日或之前和平解決該項索償。本公司將動用內部資金以向金英支付欠款。

本集團財政狀況

於二零零二年十二月三十一日，本集團約有4,700,000港元現金存放於銀行。於發出本公佈當日，本集團之現金水平降至2,800,000港元（包括向金英支付欠款）。本集團正積極與

財務顧問磋商有關籌措資金之事宜。按二零零三年二月十四日向股東寄發之通函所述，本集團計劃並與財務顧問商討可能於二零零三年二月底或三月初進一步配售股份，以籌集款項償還債務。倘計劃成功，則會為本集團集資約16,000,000港元。

於二零零二年十二月三十一日，本集團之未經審核流動負債總額約為67,000,000港元。於二零零二年十二月三十一日，本集團之總資產為202,000,000港元，而流動資產則為107,766,000港元。

結論

上述整項重組計劃對本集團有長遠正面作用，將大大促進本集團業務發展。董事認為，本集團現時及日後均會維持創業板上市規則第17.26條所規定之營運水平。當上海廠房正式投產或本公佈所述之預期時間表再度出現延誤時，本公司將另行發出公佈。

本公司各股東及投資者買賣本公司股份時務須審慎行事。

應本公司之要求，股份已由二零零三年二月十三日星期四上午九時三十分暫停買賣，以待發出本公佈。本公司已向聯交所申請股份由二零零三年二月十八日星期二上午九時三十分起恢復買賣。

承董事會命
大陶精密科技集團有限公司
行政總裁
董大勇

香港，二零零三年二月十七日

* 僅供識別

本公佈(本公司之董事共同及個別對其負上全責)所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成份；(2)公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(3)公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站「最近期公司公佈」刊登最少七日。此外，本公佈亦將於本公司網站 www.intcera.com 刊登。